

日月光一〇五年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 105 年 4 月 29 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇五年度第一季獲利報告，本公司一〇五年第一季之合併營業收入較一〇四年第四季下滑 17%，較一〇四年同期下滑 4%，為新台幣 62,371 百萬元。茲將日月光一〇五年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第一季	104 年度 第四季	104 年度 第一季
營業收入淨額	62,371	75,548	64,662
營業毛利	11,449	13,269	12,313
營業淨利（淨損）	5,206	6,801	6,292
稅前淨利（淨損）	5,656	6,572	5,506
所得稅利益（費用）	(1,318)	(1,260)	(856)
非控制權益	(175)	(322)	(181)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	4,163	4,990	4,469
基本每股盈餘(新台幣元)	0.54	0.65	0.58
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.43	0.63	0.56

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第一季	104 年度 第四季	104 年度 第一季
營業收入淨額	35,543	38,406	38,605
營業毛利	7,832	9,977	9,995
營業淨利（淨損）	3,222	5,313	5,546
稅前淨利（淨損）	4,746	6,140	5,230
所得稅利益（費用）	(529)	(1,099)	(709)
非控制權益	(54)	(51)	(52)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	4,163	4,990	4,469

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	51
電腦	12
汽車, 消費性電子及其它	37
前十大客戶佔營收比重	51

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	29
IC Wirebonding	62
Discrete and Others	9
封裝資本支出金額	62 百萬美元
打線機台數	15,629 台

測試業務產品組合	%
後段測試	78
晶圓測試	18
前段測試	4
測試資本支出金額	47 百萬美元
測試機台數	3,453 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	51
電腦	19
消費性電子	15
工業用	7
汽車電子	7
其它	1
前十大客戶佔營收比重	89
EMS 資本支出金額	2 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2016 年第二季的業績展望如下：

- 整體半導體封測事業將接近去年第四季水準，但其中系統級封裝事業將持續季節性疲弱；
- 半導體封測事業毛利率將較前季增長，但應略低於去年第四季水準；
- 電子代工服務生意量將會略低於前季水準；
- 電子代工服務毛利率應與前季水準相仿。